346A

NF・米国株S&P500半導体ETF（愛称）

NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信

［追加型投信／海外／株式／ETF／インデックス型］

NOMURA NEXT FUNDS

月次レポート

2026年10月30日

■ ファンドの目的

日本円換算したS&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数（税引前配当込み）（対象株価指数）に連動する投資成果を目指します。

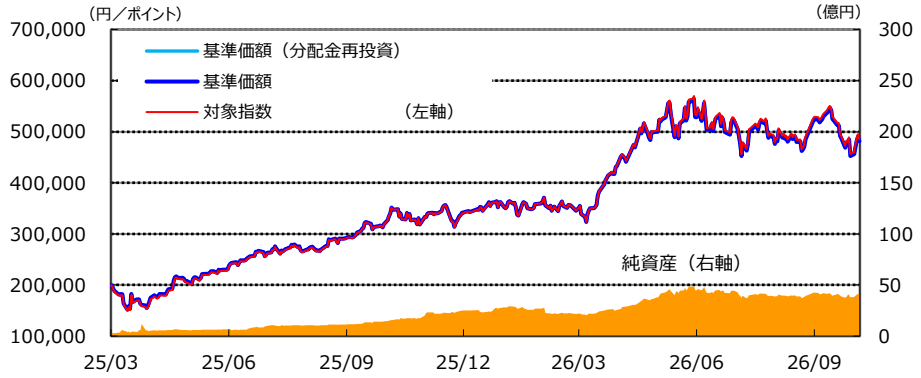
■ S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数（税引前配当込み）

S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数（税引前配当込み）は、S&P 500 半導体・半導体装置（産業グループ）指数の構成銘柄のパフォーマンスを測定します。また、指数は、フロート調整後の時価総額加重方式を採用しており、1社あたりの比重は指数全体の35%を上限としています。

ファンド情報	
設定日：	2025年3月25日
上場日：	2025年3月27日
上場市場：	東京証券取引所
信託期間：	無期限
売買単位：	1口
決算日：	毎年9月10日
Bloomberg：	346A JP <Equity>
(iNAV)	346AIV <Index>
ISIN：	JP3050680002
SEDOL：	BSVLKC9 JP
PCF配信：	あり

■ 運用実績

運用実績の推移　（日次）



純資産総額	
	40.4　億円

基準価額※	
	481,532　円

※100口当たり　分配金控除後

分配金（100口当たり、課税前）	
2026年9月	0 円
2025年9月	0 円
-	-
-	-
-	-
設定来累計	0 円

・分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。
・分配金額は、信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。また、売買益が生じても、分配は行ないません。

騰落率	1カ月	3カ月	6カ月	1 年	3 年	設定来
基準価額（分配金再投資）	-7.6%	1.2%	7.4%	38.6%	-	141.2%
対象指数	-7.7%	1.3%	8.0%	39.9%	-	143.4%

（設定来＝2025年3月25日以降）

・対象指数は、設定日当日の基準価額に合わせて指数化しております。
・基準価額（分配金再投資）の推移および騰落率は、当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものとして計算しております。従って、実際のファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮しておりません。
・騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

■ 資産内容

業種別配分	純資産比
半導体・半導体製造装置	98.2%
-	-
-	-
-	-
-	-
その他の業種（※）	0.2%
その他の資産	1.6%
合計	100.0%

※ETFを含みます。

資産構成	
株式	98.4%
その他の資産	1.6%
（指数先物	1.4%）

実質外貨比率
99.8%

・実質外貨比率は為替予約等を含めた実質的な比率をいいます。

ポートフォリオ特性値	
配当利回り（年率）	0.5%

・配当利回りは、組入銘柄の配当利回り（課税前、実績配当ベース）を組入比率で加重平均して算出しております。

組入上位10銘柄	業種	純資産比
NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	34.2%
BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	17.1%
MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	11.0%
ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	9.6%
INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	4.8%
APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	3.5%
LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	3.3%
TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	3.0%
KLA CORP	半導体・半導体製造装置	2.3%
ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	2.2%
合計		91.0%

組入銘柄数：　21　銘柄

・追加設定の計上タイミングとファンドが購入する投資対象資産の計上タイミングのずれにより、純資産に対する投資対象資産の合計比率が100%を超える場合があります。

当資料のご利用にあたっては、後記の「ご注意事項等」を必ずご覧ください。

346A NF・米国株S&P500半導体ETF（愛称）

NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信

［追加型投信／海外／株式／ETF／インデックス型］

NOMURA NEXT FUNDS 月次レポート

2026年10月30日

■ 投資リスク

当ファンドは、株式等を投資対象としますので、連動対象である株価指数の変動、組入株式の価格の下落、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替の変動により基準価額が下落することがあります。

したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、市場取引価格または基準価額の下落により、損失が生じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。投資信託説明書は、当社インターネットホームページでご覧いただけます。

■ 当ファンドに係る手数料・費用について

直接的にご負担いただく費用

〈取引所を通してお取引をされる場合に直接ご負担いただく費用〉

●売買手数料　市場を通して売買される場合、販売会社が独自に定める金額がかかります。

〈設定・換金される場合に直接ご負担いただく費用〉

●購入時手数料　ファンドの追加設定のお申込みの際には、販売会社が独自に定める額をご負担いただきます。

●その他の費用　購入価額は、基準価額に100.05%以内（2026年5月27日現在100.05%）の率を乗じた価額となります。したがって、購入時には、基準価額に0.05%以内（2026年5月27日現在0.05%）の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、購入する口数に応じてご負担いただきます。

●信託財産留保額　換金時に、基準価額に0.05%以内（2026年5月27日現在0.05%）の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

●換金時手数料　ファンドを換金される際には、販売会社が独自に定める額をご負担いただきます。

＊上記の売買手数料、購入時手数料、換金時手数料は販売会社ごとに手数料率が異なりますので、その上限額を表示することができません。

信託財産で間接的にご負担いただく費用

●運用管理費用（信託報酬）　ファンドの純資産総額に、年0.352%（税抜年0.32%）以内（2026年5月27日現在年0.352%（税抜年0.32%））の率を乗じて得た額に、有価証券の貸付を行なった場合は、日々、その品貸料の44%（税抜40%）以内の額から、当該貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用を控除した額を加算した額が、お客様の保有期間に応じてかかります。

＊上場投資信託証券に投資する場合は、信託報酬に加え、投資する上場投資信託証券に関連する費用がかかりますが、投資する上場投資信託証券とその比率があらかじめ定まっていないため記載することができません。

●その他の費用・手数料

◆対象株価指数に係る商標使用料（2026年5月27日現在）

ファンドの純資産総額に対し、年0.06%を乗じて得た額とします。

ただし、年間の商標使用料は、最低150万円とします。

◆ファンドの上場に係る費用（2026年5月27日現在）

・追加上場料：追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して、0.00825%（税抜0.0075%）。

・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%（税抜0.0075%）。

◆組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、ファンドに関する租税等。

※これらは、ファンドから支払われます。（これらの費用等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。）

上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

■S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数（税引前配当込み）の著作権等について■

S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数（税引前配当込み）はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが野村アセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®は、Standard & Poor's Financial Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数（税引前配当込み）のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

ご注意事項等

ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。ご購入（追加設定）の際には、投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

＜委託会社＞野村アセットマネジメント株式会社［ファンドの運用の指図を行なう者］

＜受託会社＞三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社［ファンドの財産の保管および管理を行なう者］

ファンドの基準価額等についてのお問い合わせ先：野村アセットマネジメント株式会社

☆サポートダイヤル☆　0120-753104（フリーダイヤル）

＜受付時間＞営業日の午前9時～午後5時

☆インターネットホームページ☆　https://www.nomura-am.co.jp/

◆設定・運用は

NOMURA 野村アセットマネジメント

商　　号：野村アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者　関東財務局長(金商)第373号

加入協会：一般社団法人資産運用業協会／

一般社団法人第二種金融商品取引業協会